

## 深圳佰维存储科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录汇总表

(2025年4月16日)

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	广发基金 吴若飞、广发基金 陈少平、中泰证券 康丽侠
<b>会议时间</b>	2025年4月16日 15:00-16:00
<b>会议地点</b>	佰维存储三楼会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	公司管理层 董办工作人员
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>Q1. 请介绍一下公司在车规存储领域的产品布局和市场策略。</b>            A1: 公司已经推出了涵盖 eMMC、UFS、SPI NOR、LPDDR、BGA SSD、存储卡在内的全面车规存储产品矩阵，系列产品支持-40~105℃宽温工作环境，并满足 AEC-Q100 车规级可靠性标准，覆盖多种容量等级。公司车规存储相关产品已在国内头部车企及 Tier1 客户量产。公司将投入战略性资源，力争成为车规存储市场的主要参与者。</p> <p><b>Q2. 公司如何应对关税政策变动所带来的影响？</b>            A2: 公司秉持立足中国、面向全球的发展战略。除国内生产基地外，公司在巴西、印度、中国台湾地区等地持续发展并打造强有力的本地化服务和生产交付能力，服务全球 39 个国家和地区的 200 余家客户。公司多元化的生产供应体系可有效对冲区域贸易政策风险。未来，公司将持续借助全球化运营、交付服务网络，进一步开拓国际一流客户和各地区性市场。面对国际贸易环境变化，公司坚信集中精力做好企业的本职工作，围绕下游客户需求，加强研发，提升竞争力是对抗风险的最有力的保障。长期来看贸易争端不会改变 AI 在各行业渗透的趋势，不会影响存算整合的发展方向，以及由此带来的新型存储形态和海量存储需求。对此，公司将持续加大研发投入，强化研发封测一体化优势，重点布局高性能存储解决方案、晶圆级先进封测、自研主控芯片等关键能力，实现差异化竞争，夯实公司在可穿戴、智能汽车、机器人等 AI 端侧的竞争优势，为 AI 时代提供更高效、更创新的存储解决方案。</p> <p><b>Q3. 公司在保障上游晶圆稳定供应方面有哪些措施？</b>            A3: 公司始终坚持多元化供应策略，已经与全球主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系，通过与主要的存储晶圆原厂签订 LTA（长期供</p>

	<p>应协议)合作,可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。通过上游资源整合优势,公司持续为下游客户提供供应稳定、性能优良的半导体存储器产品。</p> <p><b>Q4. 公司新推出的 Mini SSD 产品性能表现如何?</b>  <b>A4:</b> 佰维 Mini SSD 产品支持 PCIe4.0×2 接口与 NVMe1.4 协议,采用 3D TLC NAND 介质,读取速度高达 3700MB/s,写入速度高达 3400MB/s,容量范围覆盖 512GB~2TB,采用动态 SLC 缓存、动态磨损均衡、Trim、GC (垃圾回收)以及先进温控管理等先进技术,保护数据的完整与一致性。佰维 Mini SSD 产品凝聚了公司在存储解决方案与封测领域的多年技术积累,通过 LGA (Land Grid Array) 封装技术实现主控与闪存模块的高度集成,整体尺寸仅为 15mm×17mm×1.4mm,面积仅为传统方案 (M.2 2280 SSD) 的 8.3%。</p> <p><b>Q5. 作为存储解决方案商,公司布局晶圆级先进封测能力有哪些战略意义?</b>  <b>A5:</b> 公司是业内最早布局研发封测一体化的企业,从 2010 年开始就自建封测能力,有十几年的积累沉淀,存储封测的技术能力达到国内领先、国际一流的水平。公司在现有技术基础上进一步布局晶圆级先进封测能力,不断提升技术壁垒。公司通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级先进封测能力,一方面可以满足先进存储封装需求,为公司研发和生产先进存储产品构建技术基础,提供相关封装产能;另一方面可以与公司存储业务协同,服务公司客户对于存算合封业务的需求,为相关客户提供存储+晶圆级先进封测服务。</p> <p><b>Q6. 公司在 AI 智能眼镜上有哪些竞争优势?</b>  <b>A6:</b> 公司为 Meta 最新款 AI 智能眼镜 Ray-Ban Meta 提供 ROM+RAM 存储器,Ray-Ban Meta 智能眼镜系列搭载高通第一代骁龙 AR1 平台,该平台专门针对散热限制在功耗方面进行独特设计优化,以打造轻量化的智能眼镜。除 Meta 外,公司还进入了 Rokid、雷鸟创新等国内知名智能眼镜厂商供应链体系。公司研发封测一体化的布局,在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势,能够在低功耗、快响应等方面进行主控芯片设计、固件算法优化的同时,通过先进封测工艺能力,助力产品的轻薄小巧。未来,公司将不断深化研发封测一体化布局,延伸公司的价值链条,增强公司的核心竞争力,为客户提供更加高效高质的存储解决方案。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2025 年 4 月 16 日</p>
<p><b>备注</b></p>	<p>接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息披露等情况。</p>